**深圳市联得自动化装备股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2020-004

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | █特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 东方证券 孙宇 姜楠 刘俊清 虞文娇  温氏投资 黎明 房志宇  玄元投资 李洲  卓越投控 孙志龙  山东国惠基金 邵良文 孙艳宇  上海土星资产 林俊生  北京瑞瀚资产 王峰  鸿臻投资 吴黎征 |
| 时间 | 2020年9月18日上午10:00 |
| 地点 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司会议室 |
| 上市公司接待人员  姓名 | 董事会秘书：钟辉先生  证券事务代表：杨晓芬女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **Q1：半导体封测设备的市场环境如何？**  **A1**：全球前10大半导体设备厂商迄今仍然以美国和日本为首的海外设备厂商主导，占比高达80%,主导着全球半导体设备市场。随着贸易战和5G、AI等新技术的突破发展，国家政策引导，国内半导体产业迎来机遇和挑战，国内市场中长电科技、通富微电和华天科技是国内市场的主要封测公司，我们也在近几年积极布局并已有技术储备切入到半导体封测领域。目前公司自主研发销售的COF倒装封测设备已经达到量产标准并形成了正式订单，并与几家潜在大客户进行积极商务洽谈中。  **Q2：公司半导体业务的相关市场竞争者有哪些？对应的客户群体有哪些?**  **A2**：公司作为国内半导体倒装封测设备的设备厂商，主要对标的市场竞争者为日本芝浦、日本东丽、韩国赛可等企业。公司生产的COF倒装设备已经完工，并按客户指定的交付要求，交付至无锡英飞凌公司生产现场，该设备目前在无锡英飞凌公司处于调试阶段。同时公司的潜在客户均为国内领先的半导体封测公司，潜在市场广大。  **Q3：公司设立合资企业的背景是什么？有什么契机吗？**  **A3：**公司与其他自然人、合伙企业设立合资企业是基于公司长期发展及短期目标实现的综合考虑，公司在合资企业中持股占比51%，保证了上市公司的控制权。此外，其他出资人（合伙企业）在光伏新能源设备行业中具有成熟的研发、生产、调试团队，在行业里有15年的从业经验，同时具有甲方和乙方的角色身份，在与公司新工艺的设备开发上具有先天优势。基于以上考虑，我们针对光伏太阳能领域的技术研发及相关市场拓展都有了很好的基础,,我们相信光伏太阳能设备很快能成为公司的又一新亮点。  **Q4：公司在光伏新能源领域是生产什么设备？**  **A4：**公司合作团队的设备经验主要在组件上，在组件上率先推出叠焊机并申请了大量专利，叠焊机作为合资公司进入光伏电池设备领域的拳头产品和奠基石，会很快实现收入并产生经济效益，合资公司后期的新设备方向是ALDˎ清洗ˎ无主栅封装ˎ非标自动化ˎ串焊机等设备。在组件领域，未来几年光伏设备市场将出现结构性机会，公司将抓住这一机会迎风而上，创造新的利润增长点。  **Q5：公司在汽车电子领域有哪些战略客户?**  **A5**：2019年公司成为德国大陆集团的全球供应商，并与大陆集团捷克公司、罗马尼亚公司以及中国芜湖公司签订了七千万订单。今年公司与博世汽车公司建立合作联系，也签订了AOI检测设备的销售订单。公司的生产设备为汽车电子显示领域的广泛应用提供了技术支持及市场革新。公司供货销售给蓝思科技公司的设备同样也应用于特斯拉汽车电子显示屏上。  **Q6：公司的大尺寸设备情况如何？**  A6：公司已有供货给重庆惠科的大尺寸设备就是针对制造21.6-60寸之间的平板显示屏，根据下游面板厂商的投资大幅增长，现在我们正在对接重庆惠科新产线的设备需求，同时也在与几家大的面板厂洽谈商务细节。  **Q7：公司未来的发展战略是什么？**  **A7**：公司将持续加强在后段模组组装领域的设备研发，积极开拓大尺寸TV设备、OLED平板显示模组组装设备、AOI检测设备市场以及半导体封装设备产品等在新兴领域的应用市场，同时抓住进入汽车电子及光伏太阳能领域的机遇，通过多维度的产品布局，丰富产品种类，完善产品体系，通过内延发展孵化研发技术团队模式，形成稳健持续的发展平台。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020-09-21 |